“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项2014年工作会在京召开

日期：2014年03月25日

近日，“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项2014年工作务虚会在京召开。会议由科技部曹健林副部长主持，专项第一行政责任人、北京市副市长张工，科技部重大专项办公室、专项领导小组办公室、专项实施管理办公室及科技部、财政部、发展改革委、工信部、中科院等成员单位负责同志、专项咨询委员会及总体专家组有关专家出席了会议。

会上，总体组汇报了专项总体情况及2013年的工作进展情况，全面客观分析了专项推进过程中存在的问题并提出了相应对策，部署了专项在新的历史机遇期的工作思路及工作重点。专项自实施以来，已经在集成电路高端装备、成套工艺、关键材料、封装测试等领域取得了部分突破，一批65-28纳米高端设备通过量产验证，部分实现批量采购，40纳米成套工艺成功量产，光刻机整机集成及零部件技术水平迅速提升，封测产业加速升级，专项成果辐射相关产业应用。

曹健林副部长强调大家要充分认识专项所取得的成绩以及存在的问题，进一步提升科技创新和战略决策的信心和决心；要求专项要集中资源突破重点，与其他专项积极配合，通过与大企业合作推进产业链上下游联动，在全国和全球范围内加强协同、开放发展。